

삼성전자, 미국 시스템반도체 증설

채권 10억달러 발행해 증설자금 조달 ... 세계시장 연평균 6% 성장

삼성전자가 미국 오스틴(Austin)의 반도체 라인을 증설한다.

삼성전자는 “오스틴공장의 라인 증설을 준비하고 있으며 자금을 마련하기 위해 10억달러 채권을 글로벌 시장에서 발행할 예정”이라고 1월15일 발표했다.

글로벌본드 발행은 삼성전자 본사가 아닌 미국현지법인(SA)이 발행하는 것으로 알려졌다.

삼성전자는 현재 국내에서 경기도 기흥과 화성에 메모리와 시스템LSI(비메모리 반도체) 생산라인을 가동하고 있으며, 운양에 조립라인을 두고 있다.

해외에는 미국 오스틴에 시스템LSI 라인을, 중국에도 조립라인을 두고 있다.

삼성전자는 1월 초 한국 정부로부터 중국에 공장을 설립하는 계획에 대해 승인을 받았으며, 중장기적으로 국내에 반도체공장 추가 건설을 검토하고 있다.

월 4만장의 웨이퍼 생산능력을 갖춘 오스틴공장의 시스템반도체 라인은 제품 출하 5개월 만인 1월 초 풀가동에 들어갔다.

메모리반도체 시장은 2014년까지 연평균 1.3% 성장하는 반면, 시스템반도체는 성장률이 5.8%에 달할 것으로 전망되고 있다.

하지만, 삼성전자는 메모리반도체 시장에서는 1위를 차지하고 있으나 전체 반도체 시장의 약 80%를 차지하는 비메모리 반도체에서는 인텔(Intel) 등에 뒤처져 있기 때문에 시스템반도체 부문에 집중적으로 투자해 왔으며 2011년에는 전년대비 60% 신장한 11조원의 매출로 글로벌 4위에 오르는데 성공했다.

시장 관계자는 “삼성전자가 시스템반도체 생산라인을 증설하는 등 지속적으로 투자함으로써 명실상부한 종합 반도체기업으로 발돋움하게 될 것”이라고 기대했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/01/16>